

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】令和 5 年 8 月 16 日 (2023.8.16)

【公開番号】特開 2021-167930 (P2021-167930A)

【公開日】令和 3 年 10 月 21 日 (2021.10.21)

【年通号数】公開・登録公報 2021-051

【出願番号】特願 2020-118608 (P2020-118608)

【国際特許分類】

G 0 2 B 5/30 (2006.01)

B 3 2 B 7/023 (2019.01)

C 0 9 J 7/38 (2018.01)

C 0 9 J 7/29 (2018.01)

C 0 9 J 201/00 (2006.01)

10

【F I】

G 0 2 B 5/30

B 3 2 B 7/023

C 0 9 J 7/38

C 0 9 J 7/29

C 0 9 J 201/00

20

【手続補正書】

【提出日】令和 5 年 8 月 7 日 (2023.8.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0023】

第 1 切欠き開始点 P 1 d 及び第 2 切欠き開始点 P 2 d を通る切欠き線 1 0 e d の平面視形状は特に限定されない。切欠き線 1 0 e d は、切欠き線 1 0 e b と同様に、直線又は円弧状の曲線であってもよい。切欠き線 1 0 e d が円弧状の曲線である場合、切欠き線 1 0 e d は、四角形 1 5 の角部の頂点 P d a に向かって凸であることが好ましい。切欠き線 1 0 e d の長さの好ましい範囲は、切欠き線 1 0 e b で説明した範囲と同じとすることができる。

30

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0092

【補正方法】変更

【補正の内容】

40

【0092】

基材層としては、樹脂材料で形成されたフィルムを用いることができ、例えば上記した保護層を形成するために用いる熱可塑性樹脂として説明した樹脂材料を用いたフィルムを挙げることができる。基材層の厚みは、特に限定されないが、一般には強度や取扱い性等の作業性の点から 1 ~ 300 μm であることが好ましく、20 ~ 200 μm であることがより好ましく、30 ~ 120 μm であることがさらに好ましい。基材層は、重合性液晶化合物の硬化物層とともに位相差層として偏光性積層体に組み込まれていてもよく、基材層を剥離して、重合性液晶化合物の硬化物層のみ、又は、当該硬化物層及び配向層が位相差層として偏光性積層体に組み込まれていてもよい。

50